

第一节 重要提示

- 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、重大风险提示
- 公司已在本报告中详细描述公司经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。
- 3、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 4、公司全体董事出席董事会会议。
- 5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

√是 □否

公司聚焦于功率、MEMS、BCD、MCU等主要技术平台，向车载、人工智能（AI）、高端消费、工业控制等领域，提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式系统代工方案。

截至报告期末，公司尚未实现盈利，主要系公司属于资金密集型及技术密集型半导体行业，需要大额的前期资本投入及持续的研发投入以保持产品的技术领先，报告期内，公司研发投入、固定资产折旧金额较高，影响了公司的净利润表现，剔除折旧及摊销等因素的影响，公司2024年EBITDA（息税折旧摊销前利润）21.46亿元，同比增长131%。目前公司已成长为新能源产业核心芯片和模组的支柱性力量。

公司坚持技术、市场双轮驱动，打造全球领先的数模混合系统代工平台。2025年，公司将紧抓AI智能时代机遇，持续技术创新，在模拟IC、功率模块，以及SiC MOSFET、MEMS等新增长点的带动下，迈入新一轮高速增长阶段。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1. 公司简介
- 1.1 公司股票简称
- √适用 □不适用

股票简称	股票上市交易所和股票简称	股票简称	股票代码	变更前股票简称
芯联集成（A股）	上海证券交易所科创板	芯联集成	688469	芯联集成

- 1.2 公司存在优先证情况
- 适用 √不适用
- 1.3 联系人和联系方式

姓名	职务	电子邮箱	办公手机号码
联系地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道越北路18号	浙江省绍兴市越城区皋埠街道越北路18号	
电话	0575-88282000	0575-88282000	
传真	0575-88282009	0575-88282009	
电子邮箱	zhanghui@csic.com	zhanghui@csic.com	

2. 报告期公司主要业务简介
- 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司聚焦于功率、MEMS、BCD、MCU等主要技术平台，全力构建车载、AI、消费、工控四大领域增长引擎，重点布局新能源和人工智能两大应用领域，提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证、可靠性测试的一站式系统代工方案。

公司产品主要应用于车载、工控、高端消费、AI领域的功率控制、功率驱动、传感信号链等方面的核心芯片及模组。

- （1）功率控制与驱动：8英寸+12英寸+化合物”等多条产线，产能体系覆盖中高端功率半导体。随着12英寸产线和碳化硅不断扩产，其成本优势与技术先进性将进一步凸显，支撑在汽车、AI、高端消费、工控等领域的长期增长。
- （2）模拟IC与功率：公司的BCD平台可从高压大、大电流和高精度三个维度，提供完整的车规级晶圆代工服务。公司独具特色的BCD 60V/120V BCD +eash、BCD SOI20V、0.35um IP40V晶圆代工平台，可配合新能源汽车和工业4.0的集总SoC方案，为客户供高性价比和更具成本优势的工艺方案；10余个先进量产PCoT工艺平台，涵盖汽车40V至45V、AI类服务器热点应用、驱动IC、BMS、AFR、CAN/LIN、高压DC/DC等多种应用即将进入量产；推出55mm MCU平台，40nm MCU平台已在研发验证中。

（3）传感信号链方案：公司通过生产硅麦克风、激光雷达中的微镜、压力传感等产品，助力汽车电动化及世界智能化的进程，其中应用于高端消费、新能源汽车的第三代麦克风进入大批量生产，第四代微镜完成研发完成送样；应用于高端消费的VCMSEL产品量产，持续放量增长中；车载运动传感器验证完成，进入小批量生产阶段；消费类多轴传感器完成送样；车载激光雷达板已完成产品验证，目前前客户导入已完成，并同步开展后续产品应用领域推广。

2.2 主要经营模式

由于模块化、集成化的市场需求快速凸显，公司在晶圆代工模式的基础上，不断汲取市场需求的变化，提出“一站式系统代工”的经营模式。公司可以为客户提供包括设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证等环节在内的一站式系统代工服务。

1. 研发模式

公司持续建设完善的研发体系，坚持市场和研发紧密结合，坚持产品和技术相互支撑，实现了研发和大规模量产的无缝衔接，快速交付、持续迭代。公司的研发流程具体包括可行性评估、研发计划与立项、研发项目成本管理、研发项目实施与进度控制、工程制造验证、研发项目验收与评价等环节。

2. 采购模式

公司主要向供应商采购研发和生产所需的原材料、设备及技术服务等，公司拥有成熟的供应商管理体系与完善的供应安全体系，建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制，在与主要供应商保持长期稳定合作关系的同时，兼顾新供应商的导入与培养，加强供应链的稳定与安全。

3. 生产模式

公司具备完善的生产运营体系，采取“以销定产”的生产模式，综合考虑市场需求、原材料供应和产能情况制定生产计划，并按计划进行生产。

4. 销售模式

公司采用多种销售方式，积极通过各种渠道拓展客户，具体包括：①公司通过市场调研，主动联系并拜访目标客户，推荐与客户匹配的工艺和方案，进而展开一系列的客户拓展活动；②公司通过与客户的上游供应商、终端测试厂及各行各业协会合作，与客户建立合作关系；③公司通过主办技术研讨会等活动，以及通过参加半导体行业各类专业会议、峰会、论坛进行推广活动并获取客户；④客户通过公司网站、口碑传播等公开渠道联系公司寻求合作。

公司采用直销模式并开展销售服务，通过上述营销方式与客户建立合作关系后，与客户直接沟通并形成符合客户需求的代工方案。公司销售团队与客户签订订单，并根据订单要求提供代工服务。

2.3 所处行业情况

（1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术趋势

2024年，全球半导体行业整体复苏，根据Gartner统计，2024年全球半导体行业营收达3900亿美元，同比增长18.1%，预计2025年有望进一步上升至4050亿美元，维持12.6%的增速。世界半导体贸易统计组织WSTS也预计2025年全球半导体行业销售额将增长2%，达6922亿美元，较2024年增长11.2%。应用方面，人工智能（AI）、智能新能源汽车、新能源、物联网等新兴领域的快速发展，将驱动全球半导体行业进入新一轮增长的周期。

中国拥有全球最大且增速最快的半导体消费市场，据世界集成电路协会WICA 2024年秋季预测，中国大陆半导体市场规模将达到1065亿美元，占全球半导体市场份额的30.1%。巨大的下游市场为公司提供积极的企业政策与活跃的社会资本，正在全方位、多地域地支持国内半导体行业，核心产品越来越迅速地步国内芯片替代的快车道。

（1）人工智能的发展、国产替代和场景延伸将带来核心芯片的长期增长动力

近几年，全球AI需求呈现爆发式增长态势。AI大模型的不断涌现和迭代，使得数据中心建设规模持续扩大，服务器需求急剧攀升。据TrendForce预测，2024年全球AI服务器出货量受惠于云服务提供者（CSP）和原始设备制造商（OEM）的强劲需求，年增幅将达46%。IDC指出，中国算力规模在2024年达到252.5 EFLOPS（每秒浮点运算次数），同比增长74.1%，市场规模为150亿美元，同比增长54.9%。AI服务器作为算力的核心载体，其性能和能效要求日益严苛，对高功率密度、高转换效率和高稳定性的服务器电源需求也随之水涨船高，这为上游模组及数模混合芯片产业带来了新的市场机遇。

随着大模型、生成式AI技术的成熟，其强大的数据处理、学习化与内容生成能力，加速了人工智能技术的赋能进程。人工智能将加速渗透到应用智能汽车、工业自动化、机器人等领域，技术突破、产业融合与基础设施构建将带来未来的增长极。另一方面，国家发布“十四五”机器人产业发展规划（和《机器人产业发展规划（2021-2025年）》等相关政策，并设立重大项目进行重点支持。人工智能驱动物体实体具备的强大感知、学习与互动能力，使得人形机器人拥有广阔的应用场景。中国电子信息产业研究院预测数据显示2024-2025年，我国人形机器人产业将实现小规模量产；2026年，人形机器人产业规模将突破200亿元。作为高度集成化的技术载体，人形机器人需要通过传感器、控制、动力能源等重点产品和器件的创新，才能实现规模化量产和市场的引爆。

（2）新能源汽车、风光储能等细分赛道需求持续高涨

2024年全球新能源汽车销量突破1700万辆，同比增长35%。根据中国汽车工业协会的数据统计，中国新能源汽车销量达1286.6万辆，占全球总销量的57.0%，2024年全球新能源汽车销量突破2500万辆，复合增长率将超 30%。新能源汽车销量快速增长，将带动汽车功率半导体快速增长。

新能源发电及储能功率半导体重要应用领域，全球新能源市场仍保持稳定增长，2024年全球光伏全球新增装机容量突破600GW，国内新增装机277GW，光伏组件产量2.1亿片，风电全球新增装机136GW，国内800W、保持平稳发展，2024年中国新增智能表装机420GW，实现同比增长。同时，新能源行业也在从政策引导向市场引导转变，风光储能新能源行业仍将保持稳健发展，并且随着光伏组件和市场的引导，上述赛道发展的快车道。

（3）碳化硅SiC器件和模组的发展潜力巨大

随着新能源汽车、风光输等市场发展，碳化硅器件和模组的需求规模保持高速增长。根据 Yole数据预测，预计到2027年，以碳化硅为主要材料的第三代功率半导体市场将达629.57亿美元，其中中国用于新能源汽车领域将达49.89亿美元。

在碳中和背景下，碳化硅有望成为新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中替代硅基器件并高速增长，中国已定位为碳化硅器件和模组最大的市场，新能源汽车、光伏逆变器是本土品牌商在全球的市场份额不断提升，国产替代的空间非常广阔，随着技术的不断进步，碳化硅行业也将迎来更多从政策引导向市场引导转变，风光储能新能源行业仍将保持稳健发展，并且随着光伏组件和市场的引导，上述赛道发展的快车道。

（4）电源管理IC、MCU应用领域广泛

随着新能源汽车、风光输等市场发展，碳化硅器件和模组的需求规模保持高速增长。根据 Yole数据预测，预计到2027年，以碳化硅为主要材料的第三代功率半导体市场将达629.57亿美元，其中中国用于新能源汽车领域将达49.89亿美元。

在碳中和背景下，碳化硅有望成为新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中替代硅基器件并高速增长，中国已定位为碳化硅器件和模组最大的市场，新能源汽车、光伏逆变器是本土品牌商在全球的市场份额不断提升，国产替代的空间非常广阔，随着技术的不断进步，碳化硅行业也将迎来更多从政策引导向市场引导转变，风光储能新能源行业仍将保持稳健发展，并且随着光伏组件和市场的引导，上述赛道发展的快车道。

（5）碳化硅SiC器件和模组的发展潜力巨大

随着新能源汽车、风光输等市场发展，碳化硅器件和模组的需求规模保持高速增长。根据 Yole数据预测，预计到2027年，以碳化硅为主要材料的第三代功率半导体市场将达629.57亿美元，其中中国用于新能源汽车领域将达49.89亿美元。

在碳中和背景下，碳化硅有望成为新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中替代硅基器件并高速增长，中国已定位为碳化硅器件和模组最大的市场，新能源汽车、光伏逆变器是本土品牌商在全球的市场份额不断提升，国产替代的空间非常广阔，随着技术的不断进步，碳化硅行业也将迎来更多从政策引导向市场引导转变，风光储能新能源行业仍将保持稳健发展，并且随着光伏组件和市场的引导，上述赛道发展的快车道。

（6）碳化硅SiC器件和模组的发展潜力巨大

随着新能源汽车、风光输等市场发展，碳化硅器件和模组的需求规模保持高速增长。根据 Yole数据预测，预计到2027年，以碳化硅为主要材料的第三代功率半导体市场将达629.57亿美元，其中中国用于新能源汽车领域将达49.89亿美元。

在碳中和背景下，碳化硅有望成为新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中替代硅基器件并高速增长，中国已定位为碳化硅器件和模组最大的市场，新能源汽车、光伏逆变器是本土品牌商在全球的市场份额不断提升，国产替代的空间非常广阔，随着技术的不断进步，碳化硅行业也将迎来更多从政策引导向市场引导转变，风光储能新能源行业仍将保持稳健发展，并且随着光伏组件和市场的引导，上述赛道发展的快车道。

（7）碳化硅SiC器件和模组的发展潜力巨大

随着新能源汽车、风光输等市场发展，碳化硅器件和模组的需求规模保持高速增长。根据 Yole数据预测，预计到2027年，以碳化硅为主要材料的第三代功率半导体市场将达629.57亿美元，其中中国用于新能源汽车领域将达49.89亿美元。

在碳中和背景下，碳化硅有望成为新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中替代硅基器件并高速增长，中国已定位为碳化硅器件和模组最大的市场，新能源汽车、光伏逆变器是本土品牌商在全球的市场份额不断提升，国产替代的空间非常广阔，随着技术的不断进步，碳化硅行业也将迎来更多从政策引导向市场引导转变，风光储能新能源行业仍将保持稳健发展，并且随着光伏组件和市场的引导，上述赛道发展的快车道。

（8）碳化硅SiC器件和模组的发展潜力巨大

随着新能源汽车、风光输等市场发展，碳化硅器件和模组的需求规模保持高速增长。根据 Yole数据预测，预计到2027年，以碳化硅为主要材料的第三代功率半导体市场将达629.57亿美元，其中中国用于新能源汽车领域将达49.89亿美元。

在碳中和背景下，碳化硅有望成为新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中替代硅基器件并高速增长，中国已定位为碳化硅器件和模组最大的市场，新能源汽车、光伏逆变器是本土品牌商在全球的市场份额不断提升，国产替代的空间非常广阔，随着技术的不断进步，碳化硅行业也将迎来更多从政策引导向市场引导转变，风光储能新能源行业仍将保持稳健发展，并且随着光伏组件和市场的引导，上述赛道发展的快车道。

在碳中和背景下，碳化硅有望成为新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中替代硅基器件并高速增长，中国已定位为碳化硅器件和模组最大的市场，新能源汽车、光伏逆变器是本土品牌商在全球的市场份额不断提升，国产替代的空间非常广阔，随着技术的不断进步，碳化硅行业也将迎来更多从政策引导向市场引导转变，风光储能新能源行业仍将保持稳健发展，并且随着光伏组件和市场的引导，上述赛道发展的快车道。

公司代码: 688469

公司简称: 芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

【2024】年度报告摘要

发展机遇。随着全球AI浪潮推动对算力需求的增长、IDC建设和芯片功耗不断提升，导致高功率密度、高转换效率和高稳定性的服务器电源需求持续增长，推升电源内部功率IC和器件需求增长。此外，电源在功率密度和转换效率方面不断寻求突破，供给端面临着技术创新的潜力。通过碳化硅化和氮化镓等先进的半导体材料，有助于提升AI服务器和数据中心系统的可持续性和可靠性。

报告期内，基于客户需求，公司“系统代工”的具体业务已纷纷落地。公司持续优化经营策略，不断丰富和升级经营模式，进一步提升公司与客户之间合作方式的灵活性和多样性，增加公司与客户合作的黏性。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2024年	2023年	本报告上半 年度(%)	2022年
总资产	384,280,722,841.88	31,079,366,448.66	62.4	36,369,817,880.62
归属于上市公司股东的净资产	12,321,012,872.58	12,461,014,790.90	-1.28	5,442,761,922.46
营业收入	6,849,094,366.15	9,324,462,794.44	22.5	3,446,257,778.89
归属于上市公司股东的净利润	6,276,062,366.15	4,151,739,546.44	22.89	3,466,428,264.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4602,268,560.25	-1,568,231,760.66	净利润90.67%	-1,680,422,622.87
归属于上市公司股东的现金流量净额	-1,439,540,221.69	-2,381,489,779.13	减亏37.67%	-1,483,063,210.97
经营活动产生的现金流量净额	1,502,430,390.00	2,014,331,680.00	-27.23	1,304,381,491.47
加权平均净资产收益率（%）	-1.97	-13.84	增加14.67个百分点	-27.53
基本每股收益（元/股）	-0.54	-0.32	全部	-0.53
稀释每股收益（元/股）	-0.54	-0.32	全部	-0.53
研发投入占营业收入的比例（%）	26.39	26.72	减少0.40个百分点	16.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	1,382,989,072.36	1,526,073,269.69	1,867,484,492.21	1,981,672,007.99
归属于上市公司股东的净利润	-242,117,619.08	-226,439,162.40	-213,418,761.06	-277,561,008.22
归属于上市公司股东的现金流量净额	-266,546,022.04	-476,565,146.71	-296,122,466.01	-326,554,487.18
经营活动产生的现金流量净额	306,117,386.26	380,036,714.23	466,726,666.67	892,741,789.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

报告期末普通股股东总数(户)	146,139
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	142,003

前十大普通股股东(前十大表决权恢复的优先股股东持有股份)	持股数量(股)	持股比例(%)	持有表决权恢复的优先股数量(股)	持股比例(%)	质押、冻结或司法冻结的股份数量	股东类型
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	1,152,000,000	31.22	1,152,000,000	无	无	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	220,400,000	3.28	220,400,000	无	无	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	218,772,324	3.10	218,772,324	无	无	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	216,000,000	3.06	216,000,000	质押	980,000,000	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	177,266,020	2.51	177,266,020	无	无	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	13,464,347	0.19	13,464,347	无	无	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	10,366,000	0.15	10,366,000	无	无	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	10,000,000	0.14	10,000,000	无	无	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	10,000,000	0.14	10,000,000	无	无	境内非国有法人
浙江芯联集成电路制造股份有限公司	10,000,000	0.14	10,000,000	无	无	境内非国有法人

1. 控股股东、实际控制人及其关联方：浙江芯联集成电路制造股份有限公司，注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道越北路18号。控股股东为浙江芯联集成电路制造股份有限公司，实际控制人为浙江芯联集成电路制造股份有限公司。

2. 报告期分季度的主要会计数据

3. 报告期分季度的主要会计数据

4. 报告期分季度的主要会计数据

5. 报告期分季度的主要会计数据

6. 报告期分季度的主要会计数据

7. 报告期分季度的主要会计数据

8. 报告期分季度的主要会计数据

9. 报告期分季度的主要会计数据

10. 报告期分季度的主要会计数据

11. 报告期分季度的主要会计数据

12. 报告期分季度的主要会计数据

13. 报告期分季度的主要会计数据

14. 报告期分季度的主要会计数据

15. 报告期分季度的主要会计数据

16. 报告期分季度的主要会计数据

17. 报告期分季度的主要会计数据

18. 报告期分季度的主要会计数据

19. 报告期分季度的主要会计数据

20. 报告期分季度的主要会计数据

21. 报告期分季度的主要会计数据

22. 报告期分季度的主要会计数据

23. 报告期分季度的主要会计数据

24. 报告期分季度的主要会计数据

25. 报告期分季度的主要会计数据

26. 报告期分季度的主要会计数据

27. 报告期分季度的主要会计数据

28. 报告期分季度的主要会计数据

29. 报告期分季度的主要会计数据

30. 报告期分季度的主要会计数据

31. 报告期分季度的主要会计数据

32. 报告期分季度的主要会计数据

33. 报告期分季度的主要会计数据

34. 报告期分季度的主要会计数据

35. 报告期分季度的主要会计数据

36. 报告期分季度的主要会计数据

37. 报告期分季度的主要会计数据

38. 报告期分季度的主要会计数据

39. 报告期分季度的主要会计数据

40. 报告期分季度的主要会计数据

41. 报告期分季度的主要会计数据

序号	事项名称	发生/完成日期(月)	进展情况(月)
1	首次公开发行股票并上市	2024.09.09	24

六、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行阶段限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码: 688469 证券简称: 芯联集成 公告编号: 2025-019

芯联集成电路制造股份有限公司
关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更系芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东大会审议。
- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

证券代码: 688469 证券简称: 芯联集成 公告编号: 2025-018

芯联集成电路制造股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,726,094,310.00	1,562,096,972.88	10.53
归属于上市公司股东的净利润	1,026,266,004.44	1,062,117,000.00	-3.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-220,213,226.19	-226,568,062.00	减亏2.82%
经营活动产生的现金流量净额	171,792,666.64	986,117,266.66	-43.09
归属于上市公司股东的EBITDA	403,734,012.00	401,610,000.00	0.52
归属于上市公司股东的EBITDA利息保障倍数	1.09	1.09	0.00
研发投入占营业收入的比例(%)	-0.01	-0.01	0.00
研发投入占营业收入比例(%)	-1.80	-1.80	0.00
研发投入占营业收入比例(%)	46.21,461,771.71	47.01,146,000.00	-2.63
研发投入占营业收入比例(%)	36.43	36.43	0.00
研发投入占营业收入比例(%)	10.401,192,440.00	10.400,273,744.00	-0.26
研发投入占营业收入比例(%)	10.369,406,266.00	10.322,013,072.00	0.42

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,726,094,310.00	1,562,096,972.88	10.53
归属于上市公司股东的净利润	1,026,266,004.44	1,062,117,000.00	-3.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-220,213,226.19	-226,568,062.00	减亏2.82%
经营活动产生的现金流量净额	171,792,666.64	986,117,266.66	-43.09
归属于上市公司股东的EBITDA	403,734,012.00	401,610,000.00	0.52
归属于上市公司股东的EBITDA利息保障倍数	1.09	1.09	0.00
研发投入占营业收入的比例(%)	-0.01	-0.01	0.00
研发投入占营业收入比例(%)	-1.80	-1.80	0.00
研发投入占营业收入比例(%)	46.21,461,771.71	47.01,146,000.00	-2.63
研发投入占营业收入比例(%)	36.43	36.43	0.00
研发投入占营业收入比例(%)	10.401,192,440.00	10.400,273,744.00	-0.26
研发投入占营业收入比例(%)	10.369,406,266.00	10.322,013,072.00	0.42

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

研发投入占营业收入比例(%)

<